

证券代码：002977

证券简称：天箭科技

公告编号：2026-003

成都天箭科技股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月6日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下：

为满足公司生产经营需要，拟向如下银行申请综合授信额度肆亿元，授信内容为：流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商票保贴等业务，授信期限为12个月，具体如下：

银行名称	授信额度
中信银行股份有限公司成都高新支行	10,000万元
中国民生银行股份有限公司成都分行	10,000万元
招商银行股份有限公司成都分行	10,000万元
中国建设银行股份有限公司成都金河支行	7,000万元
工商银行股份有限公司成都东大支行	3,000万元
合计	40,000万元

上述最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

董事会授权公司管理层在批准的授信额度内负责办理上述向银行等金融机构申请综合授信的相关事宜，授权有效期为自董事会审议通过之日起计算12个月。

特此公告！

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2026年1月7日